

# 【会員限定】2024年度第3回 WBG実装WG研究会

【開催日】2024年12月5日(木)14:00~19:30

【会場】大阪大学 産業科学研究所 インキュベーション棟1階  
講義室(I-117)

大阪大学産業科学研究所F3D協働研究所研究所におけるF3D実装コンソーシアム活動におきまして、2024年度期における当該コンソーシアム活動傘下のWBG実装WG (WGB-WG)研究会を下記の内容で開催いたします。

## 【プログラム】 【次世代パワーモジュールと信頼性評価】

14:00-14:10 開会挨拶

14:10-15:00 講演①

ハイブリッド開催  
(阪大産研+ZOOM)

「次世代パワーエレクトロニクス機器・モジュールの複合環境における絶縁信頼性評価技術の開発」

富士電機株式会社 技術開発本部 先端技術研究所  
材料基礎技術研究センター 絶縁基盤研究部  
絶縁構造 Gr グループリーダー 早瀬 悠二 氏

15:00-15:50 講演②

「次世代パワー半導体の市場・技術動向と今後取り組むべき課題」

日本ゼオン株式会社 総合開発センター 研究企画部  
技術顧問 久保 実 氏

15:50-16:10 休憩・講師との名刺交換会

16:10-17:00 講演③

「パワー半導体のパッケージ組立と評価試験について」

シーマ電子株式会社 試作・設計・評価センター  
副センター長 小野寺 浩 氏

17:00-17:30 新会員企業の自社紹介

①浜松ホトニクス株式会社 ②古河電気工業株式会社

③株式会社堀場製作所

17:30-19:30 講演者を交えた意見交換会

Zoom 配信 URL

<https://us02web.zoom.us/j/89653253142?pwd=cqu6QN1ByBkSt4aSTbIRnBGY7E dhRa.1>

会場アクセス Web; <https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/access/>

申し込み・問い合わせ 大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所 WBG-WG事務局  
(TEL/FAX:06-6879-4295/E-mail:[hikita.masayuki@sanken.osaka-u.ac.jp](mailto:hikita.masayuki@sanken.osaka-u.ac.jp)) 匹田 政寿

主催:大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所

後援:一般財団法人大阪大学産業科学研究所協会